

# 第46回公開技術講座開催のご案内

(統一テーマ「次世代社会に貢献する高機能化技術の最近の進歩」)

一般社団法人  
エポキシ樹脂技術協会  
＜協賛＞一般社団法人  
日本塗装技術協会

エポキシ樹脂は、塗料分野、電気電子分野、土木・建築・接着剤分野など様々な分野で活用され、今後、デジタル社会を支える主要な産業資材として、ますます発展が期待されております。

そこで、弊協会では「次世代社会に貢献する高機能化技術の最近の進歩」を統一テーマとして、第46回公開技術講座を対面およびオンラインによるハイブリッドセミナー形式にて開催することになりました。

エポキシ樹脂に直接関わる方々を初めエポキシ樹脂に関連する業務に携わっておられる方々には、エポキシ樹脂技術に関して、より広範な情報を取得しさらに理解を深めていただき、実際の業務に生かしていただく絶好の機会と考えます。奮ってご参加ください。

開催日： 2023年8月3日(木) 8月4日(金)

開催形式： 対面およびオンラインによるハイブリッドセミナー形式

(会場：関西大学東京センター 添付資料をご参照ください)

プログラム： 統一テーマ「次世代社会に貢献する高機能化技術の最近の進歩」

2023年8月3日(木)

時間	テーマ	講師
9:30~10:30	ポリロタキサンを用いた熱硬化性樹脂の高機能化 特異的な分子内運動を行うポリロタキサンが応力緩和材料として注目されている。ポリロタキサンを熱硬化性樹脂の靱性改質剤として用いた場合の相構造や硬化物物性について紹介する。	地独)大阪産業技術研究所 有機材料研究部 研究フェロー 工学博士 大塚 恵子 氏
10:30~11:30	エポキシ樹脂硬化における多官能チオール技術動向 エポキシ樹脂組成におけるチオールの役割や特性について、(株)レゾナックが持つ多官能二級チオールを中心に技術動向を紹介する。	(株)レゾナック 機能性化学品事業部 特殊化学品部アシスタントマネージャー 浅川 顕太 氏
11:40~12:40	エポキシ樹脂の低温硬化技術について 光または熱潜在性硬化剤を用いたエポキシ樹脂の低温アニオン硬化について講演者らの研究を中心に解説する。	東京理科大学 創域理工学部 先端化学科 教授 工学博士 有光 晃二 氏
12:40~13:30	＜昼休み休憩＞	
13:30~14:30	自動車塗装におけるCO <sub>2</sub> とVOCを同時削減するVOC回収技術 自動車塗装乾燥工程でのCO <sub>2</sub> とVOC排出を大幅に削減するVOC回収技術について効果および今後の課題を報告する。	マツダ(株) 技術本部 車両技術部 塗装技術グループ マネージャー 河瀬 英一 氏
14:30~15:30	球状で負の熱膨張を発現するフィラーの紹介 弊社では負の熱膨張を発現するフィラーを開発しました。球状の負エポキシ樹脂と混練して使用しやすくなっております。本フィラーの開発経緯、評価結果、負膨張メカニズムなどをご紹介します。	三菱ケミカル(株) インフォメーション&エレクトロニクス本部 戦略企画部 半導体次世代開発グループ マネージャー 横山 昌弘 氏
15:40~16:40	重合性液晶を用いた高熱伝導かつ低誘電率エポキシ樹脂の開発 モノマーの状態では液晶性を示す重合性液晶化合物を、高熱伝導かつ低誘電材料に適用するための試みを紹介する。	JNC石油化学(株) 未来技術研究センター グループサブリーダー 工学博士 藤原 武 氏

2023年8月4日(金)

時間	テーマ	講師
9:30~10:30	樹脂材料技術による FRP の高機能化 近年、軽量・高強度などの特徴から金属代替材料として FRP への期待が高まっている。本講演では樹脂材料の特性を活かした FRP の高機能化について当社開発事例を中心に紹介する	(株)ADEKA 研究開発本部 機能高分子開発研究所 構造材料研究室主任研究員 工学博士 森野 一英 氏
10:30~11:30	次世代通信向けを中心とした各種セラミックスフィラーの紹介 昨今、セラミックスフィラーにも誘電特性・熱特性等様々な機能が求められている。本講演では、次世代通信向けを中心に、当社セラミックスフィラー製品及び近年の開発品に関して紹介する。	デンカ(株) 第四製造部 技術課 岡部 拓人 氏
11:40~12:40	電子材料向けエポキシ樹脂の紹介 本講演では、半導体パッケージの微細配線化、薄型化、多層化および低伝送損失化をターゲットとした、半導体封止材および絶縁材向けエポキシ樹脂の開発について紹介する。	三菱ケミカル(株) 三重研究所 高機能化学・情電研究室 電子光学材料グループ 学術博士 木田 紀行 氏
12:40~13:30	<昼休み休憩>	
13:30~14:30	半導体封止材料の技術と開発動向 半導体封止材料の基礎と先端アプリケーションにおける課題・開発動向について概説します。	パナソニックイタダストリー(株) 電子材料事業部 課長 辻 隆行 氏
14:30~15:30	グラフェンの製造方法とエポキシ中でのグラフェンの剥離分散 グラフェンの製造方法について概説し、エポキシ樹脂への分散とその機械的特性について説明する。	早稲田大学 理工学術院 准教授 工学博士 荒尾与史彦 氏
15:40~16:40	新たな分子設計に基づく熱硬化性樹脂の高機能化 本講演では、新たな分子設計に基づく高耐熱性エポキシ樹脂や新規 IPN 形成法の開発など、我々の最近の研究について紹介する。	横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 工学博士 大山 俊幸 氏

参加資格 : 特に弊協会会員に限定するものではありません。一般の方も参加可能です。

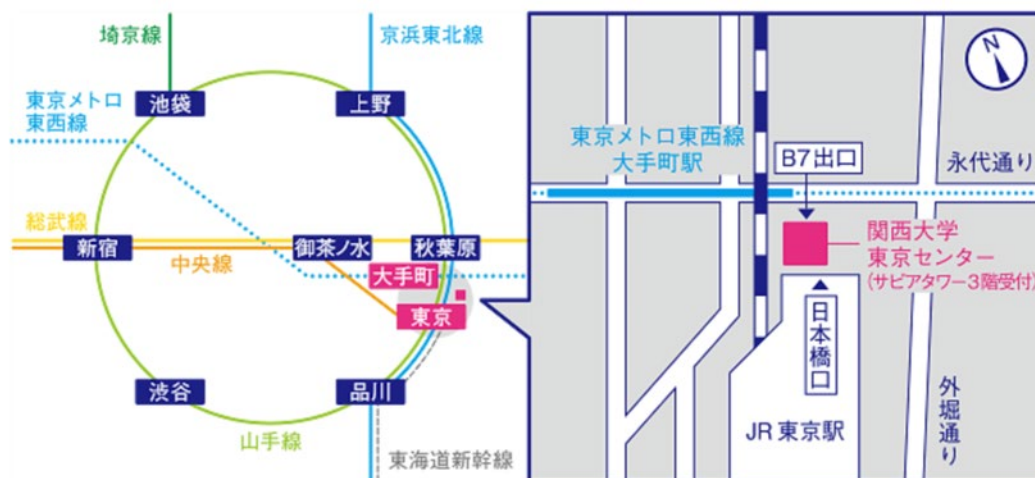
受講料 :

受講料 (消費税込み)	
会員 *	18,000 円
非会員	35,000 円

\* 受講料につき正会員、特別会員 1名、維持会員 2名、特別維持会員 3名までは無料です。

### 関西大学東京センターについて

<交通アクセス>



〒100-0005

東京都千代田区丸の内 1-7-12 サビアタワー9階

TEL.(03)3211-1670(代)

## お申込みの要領について

お申込み方法 本案内状の申込書に必要事項を記載の上、弊協会宛に電子メールまたはFAXにてお申込みください。（同様な内容を、電子メールでお送り頂いても結構です。）これを受けて、弊協会より受講の可否をご連絡いたします。可の場合には、受講料の請求書を郵送いたします。受講料のご納金を確認後、領収書を郵送いたします。

対面受講については会場の都合により、人数に制限があります（約70名）。応募が人数制限を超えた場合は受付を打ち切りオンライン受講にご変更いただけます。

今回の対面受講ではお弁当は用意しておりません。ただし、会場へのお弁当持ち込み、食事は可能です。

<締切日> 2023年7月28日

<申込先> E-mail: [epoxygk@nifty.com](mailto:epoxygk@nifty.com) FAX 03-3235-9012

〒162-0842 東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1-2 タイホービル102

一般社団法人 エポキシ樹脂技術協会 TEL 03-3260-1721

<振込先> みずほ銀行 飯田橋支店 普通口座 3072683 一般社団法人 エポキシ樹脂技術協会

<オンライン受講にあたって>

①視聴に必要なURLおよびテキストは、開催前日までにご参加の方へメールでご案内します。②URLはセミナーに参加する方のみ利用可能とし、再配布を禁止します。③受講者は、動画を録画・キャプチャーすること、SNSなどへのアップも禁止します。もし、発見した場合、事務局は削除を要求できることとします。④セミナーの内容や受講者の個人情報などはセミナー内のみとし、口外しないでください。システムトラブルなどにより、画像・音声に乱れが生じた場合も再送信や返金はできませんので、予めご了承ください。音声、画像は受講者でご調整ください。⑤配信中、異常と思われる接続を発見した場合、予告なく切断することがあります。⑥接続環境は【パソコン、有線またはWi-Fiのインターネット環境】推奨です。⑦このセミナーの運営事務局を担当する、株式会社サンクよりご連絡をいたしますので、ドメイン名 (@55cinq.com) からのメールを受信できるようにしてください。

### 「第46回公開技術講座」申込書

受講者ご氏名	貴社名・所属部課	E-mail アドレス	対面受講	オンライン受講

請求書・領収書 送り先	(〒 ) 住所  TEL :                      FAX :	受講料  円	銀行振込予定日 みずほ銀行飯田橋支店 2023年 月 日
----------------	----------------------------------------------------	--------------	------------------------------------

JSERT

一般社団法人 エポキシ樹脂技術協会  
〒162-0842 東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1-2 タイホービル102号  
TEL (03) 3260-1721 FAX (03)3235-9012  
E-mail epoxygk@nifty.com  
<https://epoxygk.jp>